



半導体実装プロセスの開発を得意とするコネクテックジャパンと資本業務提携

株式会社バルカー(本社 東京都品川区、代表取締役会長 CEO 瀧澤利一 以下、バルカー)は、樹脂や繊維など多種多様な素材に対して低温で半導体や電子部品を実装する独自技術を持つコネクテックジャパン株式会社(本社 新潟県妙高市、代表取締役 CEO 平田勝則、以下 CTJ)の株式の一部を取得し、両社が共同で技術開発を行う資本業務提携をしました。

昨今の IoT、5G、AI、EV 化など、急速なデジタル技術革新や事業変化が進む環境において、バルカーはお客さまと共にまだ満たされていない潜在的なニーズを掘り起こし、要求する技術力に裏付けされた製商品(H)を販売するだけでなく、接合部の締結管理や機器の予知保全といったサービス(S)とを融合して、真のソリューション提供を行う H&S 企業への変貌を目指しています。

今回の資本業務提携により、バルカーのふっ素樹脂事業やシール製品事業で蓄積したノウハウと、CTJ の低温実装技術および同社パートナー企業が持つ広範な技術、さらに各種アプリケーションに関する経験・ノウハウとを融合させ、今後急速に変化する事業環境に対応します。そして、H と S の架け橋となる技術の共同開発を加速させることでお客さまの幅広いニーズの具現化に貢献してまいります。

■株式会社バルカーについて

1927年の創業以来、社名の由来でもある「Value(価値)」と「Quality(品質)」に対するあくなき追求を続け、工業用シール製品、ふっ素樹脂加工製品を提供。

現在は、石油精製・石油化学・製鉄・エネルギープラント・自動車・油空圧機械・建設機械・半導体製造装置などさまざまな産業向けに配管・機器用シール材を扱う“シール製品事業”、ふっ素樹脂を軸に複数の機能を兼ね備えた製品を扱う“機能樹脂製品事業”、将来の成長が期待され、環境負荷低減に関連する“シリコンウエハーリサイクル事業他”の3製品事業を軸に展開。

■コネクテックジャパン株式会社について

世界初の半導体実装受託開発事業による新たな雇用創出、市場創出を目指し 2009 年創業。自社開発の低温実装「Monster PAC®」を軸に、多くのパートナー企業の技術をコネクティし顧客要望を具現化。IoT向け製品を主力に年間 200 件を超える実装開発案件を受託

以上

本件に関するお問い合わせ

株式会社バルカー 広報担当

TEL: 03-5434-7370 FAX: 03-5436-0560

<https://www.valqua.co.jp/inquiry/form/jp/index.php>
